

Title (en)  
Carrier device for plating

Title (de)  
Tragvorrichtung für die Galvanotechnik

Title (fr)  
Système de transport pour la galvanoplastie

Publication  
**EP 1972600 A1 20080924 (DE)**

Application  
**EP 07405096 A 20070321**

Priority  
EP 07405096 A 20070321

Abstract (en)

Modification method for the metal-containing surface (1) of an electroplating basket (10) used to hold metal (4) for dissolving in an electrolyte comprises oxidizing the surface. Independent claims are included for: (A) a method for producing electroplating baskets in which their metal-containing surfaces are modified as described; (B) electroplating baskets which have an iron oxide layer on the surface (5) which contacts the metal to be dissolved, with a superficial density of 3.5 - 10.5 g/m<sup>2</sup>, especially 5.5 - 6.5 g/m<sup>2</sup>; and (C) use of the baskets in electroplating in which the metal to be dissolved is a pure metal or alloy, especially zinc.

Abstract (de)

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Modifikation einer metallhaltigen Oberfläche (1) einer Tragvorrichtung (10) zum Auflösen von metallischen Feststoffen, insbesondere eines Lösekorbs, in der Galvanotechnik. Dabei wird die metallhaltige Oberfläche (1) der Tragvorrichtung (10) oxidiert und bevorzugt in eine Oberflächenschicht (2) aus katalytisch aktiven Metalloxiden umgewandelt. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren lassen sich besonders vorteilhafte Tragvorrichtungen (10) mit Oberflächenschichten (2) aus Eisenoxid herstellen, welche sich im Besonderen zur Auflösung von Zinkmetall in einem galvanischen Prozess eignen.

IPC 8 full level

**C01G 9/00** (2006.01); **C23C 22/62** (2006.01); **C23F 1/32** (2006.01); **C25D 21/18** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**C23C 22/62** (2013.01); **C25D 21/18** (2013.01)

Citation (search report)

- [X] DE 10010316 A1 20010906 - SIEMENS AG [DE]
- [DX] DE 29605315 U1 19960530 - SURTEC GMBH [DE]
- [A] JP H0610200 A 19940118 - KAWASAKI STEEL CO
- [A] JP 2003073899 A 20030312 - NIPPON HYOMEN KAGAKU KK
- [A] JP S5532701 A 19800307 - MITSUI MINING & SMELTING CO
- [A] US 2004089553 A1 20040513 - SEKIGUCHI OSAMU [JP], et al

Cited by  
EP3222757A1

Designated contracting state (EPC)  
CH DE LI PL

Designated extension state (EPC)  
AL BA HR MK RS

DOCDB simple family (publication)  
**EP 1972600 A1 20080924**

DOCDB simple family (application)  
**EP 07405096 A 20070321**